

- **Aufbau- und Verbindungstechnik**
 Chip (LED, PD, andere) / Chip auf Submount (LD, QCL)
 auf Sockel/Träger (TO41; TO46; SOT 5.6mm; SOT9mm; TO5, TO8, TO3; Keramik, PCB, andere)
 Submounts, Thermistoren, Peltierelemente etc.
 - o Chipkleben (manuell, automatisch für TO46; TO41)
 - o Drahtbonden (manuell Au ball- wedge, automatisch Au ball-wedge für TO46/ TO41)
 - o Verkappen (N2)
 - o Optischer Verguss
 - o Messtechnik

- **Faserkopplung**
 Aktive Kopplung von LD/LED/APD/PD
 an optische Fasern (MM, SM, SM-polarisationserhaltend, POF, andere)
 Bauformen Pigtail, Receptacle, TOSA/ROSA
 Klebtechnologien, Laserschweißen (manuell, automatisch)

- **Optische Module**
 Aufbau optischer Module (BF, DIL, HHL, kundenspezifische Bauformen)
 Faserkopplung, Temperaturregulation, optische Elemente, etc. enthalten

- **Spezialkonfektionierungen LWL**
 Konfektionierung von LWL (SM, MM, HCS, POF, etc.) in Spezialferrulen
 Verarbeitung spezieller Kabel
 Herstellung spezieller LWL Kollimatoren

- **Design und Entwicklung**
 Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Bauelementen (PIN TIA, etc.)
 Entwicklung von kundenspezifischen Modulen und Baugruppen für LAN, Sensorik,
 Medizintechnik, etc.
 Design, Prototypen, Serienfertigung, Qualifizierung